



### PRODUCT DESCRIPTION

Laird Tflex™ HD80000 is the latest product in the High Deflection gap filler series. Tflex™ HD80000 combines 6 W/mK thermal conductivity with superior pressure versus deflection characteristics. The combination will allow minimal stress on components while also yielding low thermal resistance. As a result, less mechanical and thermal stresses will be experienced within your device.

The Tflex HD80000 material is extremely soft, but also can be handled and applied manually without the need to add a fiberglass or other reinforcement layer, maintaining the superior thermal performance of the product.

### FEATURES AND BENEFITS

- 6 W/mK thermal conductivity
- Low pressure versus deflection
- Excellent surface wetting for low contact resistance
- No fiberglass reinforcement
- Minimizes board and component stress
- Environmentally friendly solution that meets regulatory requirements including RoHS and REACH

### SPECIFICATIONS

TYPICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Construction & Composition	Ceramic filled silicone sheet	N/A
Color	Teal	Visual
Thickness Range	1 mm (0.040") - 5.0mm (0.20")	N/A
Thickness Tolerance	+/- 10%	N/A
Thermal Conductivity (W/mK)	6.0	Hot Disk
Density (g/cc)	3.3	Helium Pycnometer
Hardness (Shore 00, 3 sec)	40	ASTM D2240
Hardness (Shore 00, 30 sec)	32	ASTM D2240
Outgassing TML (weight %)	0.3	ASTM E595
Outgassing CVCM (weight %)	0.04	ASTM E595
Temperature Range	-40°C to 150°C	Laird Test Method
Rth @ 50 mils, 10 psi	0.330	ASTM D5470 (Modified)
Dielectric Constant @ 1 MHz	9	ASTM D150
UL Flammability Rating	V-0	UL 94
Volume Resistivity	1.06 x 10 <sup>16</sup>	ASTM D257

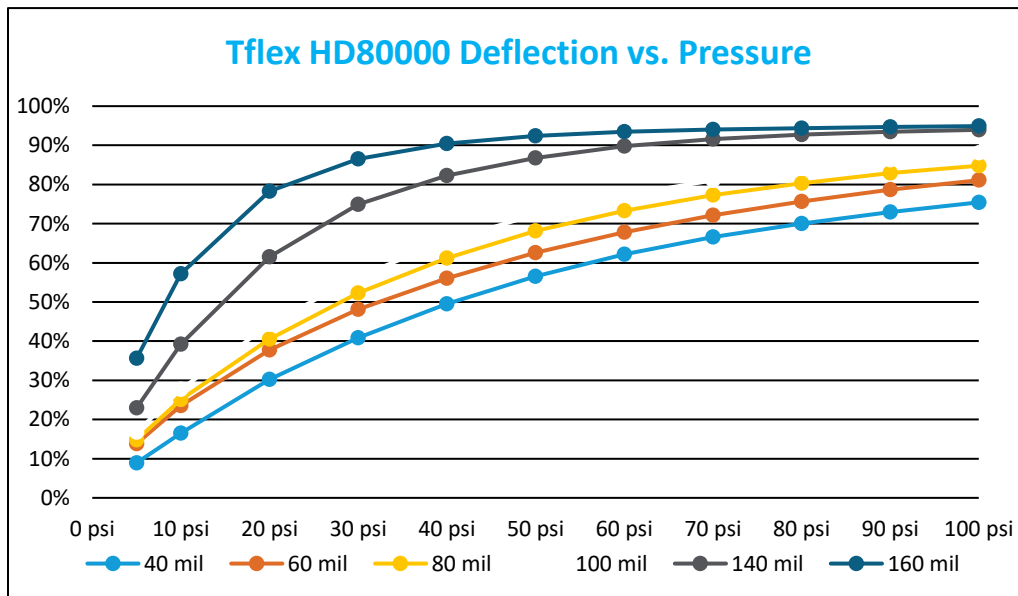
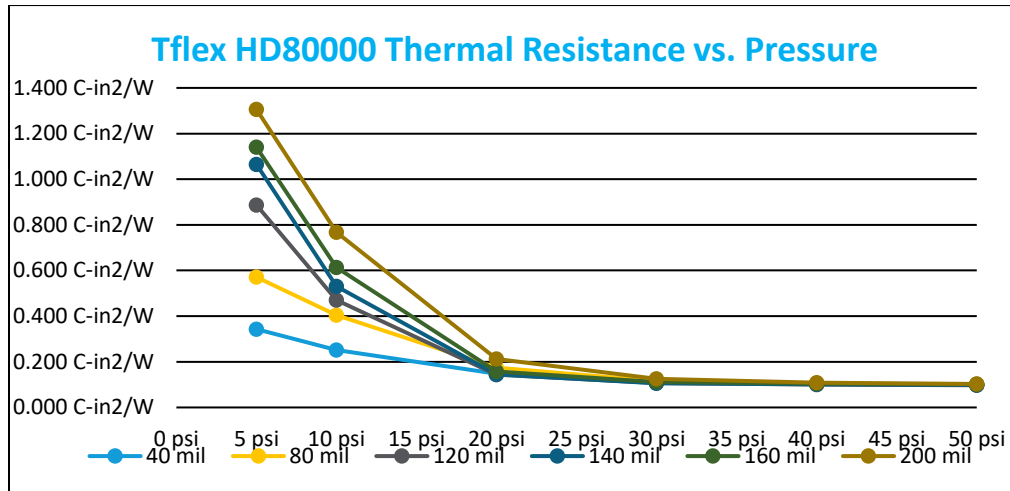
USA: +1.866.928.8181

Europe: +49.8031.24600

Asia: +86.755.2714.1166

[www.lairdtech.com](http://www.lairdtech.com)





## AVAILABILITY

### STANDARD THICKNESSES

- 1.0 mm (0.040") to 5.0 mm (0.200") thick material available in 0.25mm (0.010") increments
- Available in standard sheet sizes of 9" x 9" or custom die cut parts

## PART NUMBER SYSTEM

Tflex™ indicates Laird elastomeric thermal gap filler product line. HD8xxxx indicates Tflex HD80000 product line with thickness in microns

### EXAMPLES:

- Tflex™ HD81000 = 1000 microns / 0.040" thick Tflex™ HD80000 material



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.